

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-02

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：线上/电话会议
参与单位名称	新华基金、民沅资管、聚众鑫创投、初华资本、中邮证券
时间	2026年3月2日-3日
地点	公司会议室，线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：陈国兵 证券事务代表：杨佳睿
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 2026 年定增项目具体情况，以及时间安排？</p> <p>答：（1）公司 2026 年向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 10 亿元，其中 7 亿元拟投入特色高压功率半导体器件及功率集成电路晶圆代工项目，3 亿元用于补充流动资金。特色高压功率半导体器件及功率集成电路晶圆代工项目计划使用广芯微现有厂房及附属设施并进行改造，拟通过购置生产设备、检测仪器及软件系统等，新建 6 英寸功率半导体晶圆代工生产线以提升晶圆代工产能。项目建成达产后，预计将新增适用于高压、大功率领域的 IGBT、特高压 VDMOS 和 700V 高压 BCD 等产品代工产能 6 万片/月。（2）公司于 2026 年 2 月 26 日召开董事会审议通过定增预案，后续将提交股东会审议本次发行方案及相关议案，股东会审议通过及申报文件齐备后将正式向深交所提交申请，深交所审核通过并获得中国证监会同意注册批复后方可实施。在获得深交所审核通过及中国证监会注册后，公司将向深交所和登记结算公司申请办理股票发行和上市事宜，完成本次发行全部批准程序。</p> <p>2、请介绍下晶圆代工厂广芯微电子产能爬坡情况，以及未来产能规划？</p> <p>答：（1）广芯微电子聚焦特色高压功率半导体器件及功率集成电路晶圆代工业务，一期规划产能为 6 英寸硅基功率器件月产 10 万片，广芯微电子自 2023 年底通线量产以来，产出逐步提升至 2024 年底的 6,000 片/月、2025 年底的 4 万片/月，已成功实现</p>

MOS 场效应二极管（电压覆盖 45-200V）全系列产品及 VDMOS（电压覆盖 60-2,000V）等多款产品的量产；高压 IGBT 和 700V 高压 BCD 等产品亦已顺利进入客户流片与导入阶段。（2）受市场需求及产品结构调整影响，公司于近期启动定增工作，拟募集 7 亿元用于广芯微电子项目扩产，扩充产能聚焦高压、大功率应用场景，投产 IGBT、特高压 VDMOS 及 700V 高压 BCD 等产品；在 2026 年定增募集资金到位之后，公司将尽快实现一期项目满产。募资资金到位之前，公司会根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

3、广芯微电子投建产线为 6 英寸，是否有市场竞争力？

答：（1）功率半导体行业普遍具有“小批量、多品种、定制化”的典型特征，相较于大尺寸晶圆产线，6 英寸产线在应对多样化、快速迭代的产品需求时，具备天然的生产柔性及经济性优势，能够以更低的生产成本、更快的研发转化速度，响应客户在中高压、特种应用场景下的定制化需求，契合功率半导体代工市场从“通用产能”向“场景定制产能”转型的发展趋势；在性能与可靠性层面，6 英寸晶圆因尺寸更小，在同等厚度条件下具备更优的结构强度与稳定性，由热膨胀系数失配引发的翘曲现象更为轻微，特别是在高压/特高压、大功率半导体产品方面，其性能保障和可靠性更高、适配性更强。

（2）AI 产业浪潮正深刻重塑全球半导体产能布局，伴随 AI 算力芯片的需求激增，台积电、三星等国际大厂纷纷将产能资源向利润更高、需求更旺的先进制程倾斜，主动收缩成熟制程及 6、8 英寸产线产能；功率半导体作为 AI 数据中心、电力系统建设、清洁能源及工业控制等核心领域的关键器件，市场对高压、高效、高可靠功率器件的需求持续升温。因此，台积电、三星等国际大厂的产能调整进一步加剧了全球成熟制程供给缺口，功率半导体晶圆代工需求持续扩大，也为国内成熟制程晶圆厂带来一轮难得的客户导入机会与盈利弹性。

（3）广芯微电子的设备配置在国内 6 英寸功率半导体晶圆厂中具备较强的制造水平，已拥有深沟槽刻蚀工艺、平坦浓硼工艺及缺陷控制技术等多项核心技术工艺，并拥有应用于 700V 高压 BCD 产品的智能功率集成电路的工艺平台，工艺平台能力属业内较高端的平台，产品线丰富，尤其在高压、特高压领域具有一定的优势；同时，广芯微和芯微泰克可以为客户提供正面+背面（超薄、背面加工、重金属掺杂等）一体化的特色工艺全套解决方案，可覆盖大多数功率半导体器件及功率集成电路产品，并

	<p>利用自身丰富的经验，赋能设计公司，减少开发周期。</p> <p>风险提示：本记录表如有涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2026-03-04